



TIS-30FIP是一种镍/石墨填充的硅胶膏，具有非常低的硬度，当它被用作底盘和组件之间的垫圈时有相对低的压缩应力。它还被设计用于高达60%的高压缩率，因此垫圈可以补偿衬底的大公差。产品具有良好的屏蔽性能，机械性能平衡。低密度低粘稠度便于快速涂胶点胶，可以经济有效的解决自动点胶方案。

Ziitek的自动点胶系统，将导电弹性体EMI屏蔽和接地垫片涂在金属或塑料基体上。本产品特别适用于基站，pda, PC卡，收音机，移动电话，以及许多其他铸造或塑料外壳和封装电子组件。

### 特点和优点

》产品以填料的形式减少原材料成本、贮存成本以及产品加工或组装时间

》室温固化填料材料消除需要昂贵的热固化系统,允许使用廉价的塑料或金属基质

》单组分产品不需要混合加工,从而缩短生产周期和减少浪费

》操作系统简易方便，允许快速程式转换,最小的工具投资，新设计和原型开发可以在24至48小时内完成

》在配合面缺乏机械刚度的情况下，低压缩力使SN化合物成为一种很好的选择

》自动点胶垫圈为组件提供更关键的包装空间和更小的包装尺寸

》高效率屏蔽效果：  
85~100dB up to 10GHz

TIS-30FIP 系列特性表		
产品特性	典型值	测试方法
结构成分	镍/石墨填充硅胶	*****
屏蔽性能200MHz~10GHz (dB)	> 80	MIL-DTL-83528C
硬度 ShoreA	45	ASTM 2240
固化前密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.6	ASTM D792
固化后密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.8	
使用温度范围	-50~125°C	*****
体积电阻率	≤0.04 Ω.cm	ASTM D257
压缩量	10%~60%	ASTM D575
20%压缩率应力 (lb/in)	0.6	
40%压缩率应力 (lb/in)	1.6	
防火等级	94 -V0	UL E331100
粘接强度 (铝件)	> 150 N/cm <sup>2</sup>	LT-FIP-CLE-03
固化条件	15°Cto40°C,RH50% ,24hours	*****

### 应用

》汽车点火器灌封;一般灌封;温度探测器灌封

》磁心黏贴; 适用于尖端型LED

》继电器汽孔封密; 对橡胶, 陶瓷, PCB底板, 塑料均有良好之粘贴效果

》变压器; 传感器; 线圈; 灌封

》对金属, 塑料, 均有很好之粘贴效果; LCD气孔封口; 涂层及盖封; 散热片装配, 热传感器灌封, 导热产品灌封

》光学及医疗配件粘合; 医疗金属针嘴固定

导热材料

导热工程塑料

发热材料

屏蔽材料

发泡硅胶

模切制品

加拿大 Canada

TEL: +001-604-2998559  
E-mail: frances@ziitek.com.tw  
[Http://www.thermazig.com](http://www.thermazig.com)

台湾 Taiwan

TEL: +886-2-22771007  
E-mail: frances@ziitek.com.tw  
[Http://www.ziitek.com.tw](http://www.ziitek.com.tw)

东莞 Dongguan

TEL: +86-769-38801208  
E-mail: frances@ziitek.com.tw  
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)

昆山 Kunshan

TEL: +86-512-57816297  
E-mail: kelvin@ziitek.com  
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)

杭州 Hangzhou

TEL: +86-571-63850366  
E-mail: alex@ziitek.com  
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)

长沙 Changsha

TEL: +86-731-86949836  
E-mail: jor@ziitek.com  
[Http://www.ziitek.com.cn](http://www.ziitek.com.cn)